

報道関係者各位

2010年2月5日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

Intel Core i7とX58チップセット用に最適化された DDR3 トリプルチャネルメモリー 容量 6GB(2GB×3枚セット)、CL=7-7-7-20、DDR3-1600MHz、XMP 対応！ Airflow ファンを同梱した最上位 DOMINATOR GT シリーズ CMG6GX3M3A1600C7

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel Core i7とX58チップセット用に最適化された DDR3 トリプルチャネルメモリー。容量 6GB(2GB×3枚セット)、Airflow ファンを同梱した最上位 DOMINATOR GT シリーズ CMG6GX3M3A1600C7 を2010年2月6日より全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

DDOMINATOR GT シリーズ CMG6GX3M3A1600C7 は、PC3-12800(DDR3-1600MHz)規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリです。トリプルチャネル動作に最適な 2GB メモリの 3 枚セットです。Intel Core i7 と X58 チップセットのプラットフォームで最適なパフォーマンスが発揮できるよう設計されたモデルです。冷却用の AirFlow ファン同梱しています。

DOMINATOR GT モジュールは、厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリーモジュールです。選別されたチップは高い信頼性能をもちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。



放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる Corsair Memory 独自の冷却技術 DHX(Dual-Path Heat Exchange)を搭載しています。DHX は伝導と対流という 2 つの熱消散経路で従来では難しかったプリント板(PCB)内の冷却※を実現しています。

※標準のチップパッケージ方式ボールグリッドアレイ(BGA)では、グリッドとして編成されたはんだボールの端子が回路基板に接続するリードとなり、チップから生成される熱の 50%がプリント板へ伝導されます。そして従来のヒートシンクは、チップの前面にしか取り付けられないため、チップの背面から生じる熱を除去することができませんでした。Corsair Memory 独自の冷却技術 DHX は、この問題を解決しています。

簡単に安定したオーバークロックを行える機能として、インテルが独自に仕様を策定した規格 XMP(Extreme Memory Profile)に対応しています。対応マザーボードにて、簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

型番は CMG6GX3M3A1600C7。容量は 2GB × 3 枚の合計 6GB。メモリ規格は PC3-12800(DDR3-1600MHz)、デスクトップ用 240Pin DIMM メモリ。転送クロックは 1600MHz。CAS レイテンシは CL=7-7-7-20。ヒートシンクを搭載。サイズは 53×133mm。AirFlow ファンを同梱しています。永久保証が提供されます。RoHS 適合した環境にやさしい製品です。

【CMG6GX3M3A1600C7 製品特徴】

・PC3-12800(DDR3-1600MHz)

DOMINATOR GT シリーズ CMG6GX3M3A1600C7 は、PC3-12800(DDR3-1600MHz)規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリです。トリプルチャネル動作に最適な2GB メモリの3枚セットです。Intel Core i7とX58チップセットのプラットフォームで最適なパフォーマンスが発揮できるよう設計されたモデルです。冷却用の AirFlow ファン同梱しています。

・オーバークロック性能を実現した DOMINATOR GT

厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリーモジュールです。選別されたチップは高いオーバークロック耐性をもちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。高い信頼性と最高のオーバークロック性能を提供いたします。

・放熱を最大化する独自の冷却技術 DHX

DHX(Dual-Path Heat Exchange)は、放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる Corsair 独自の冷却技術です。メモリーモジュールから熱を効果的に除去するために伝導と対流という 2 つの熱消散経路を利用しています。

・プリント板も冷却する優れた伝導熱消散

効率の良い伝導熱消散経路を構築するために、特別なプリント板(PCB)を採用しています。プリント板(PCB)のグラウンド層に銅を採用することにより、プリント板内の熱を内側のアルミニウムヒートシンクへ伝導させ効率よく消散いたします。この熱消散経路は非常に効果的に、チップの背面から生じる熱を除去いたします。

・オーバークロック機能 XMP 対応

XMP(Extreme Memory Profile)は、インテルが独自に仕様を策定した規格です。SPD を拡張し自動的にメモリのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードにて、簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

・AirFlow ファン同梱

メモリ上部に搭載する特殊なメモリ冷却システム Airflow ファンを同梱しています。Airflow ファンは、60mm 制御ファンを 2 基搭載し、メモリーサブシステムに衝突気流を発生させ冷却いたします。ほとんどのマザーボードに簡単に取り付けることができます。

・Corsair Memory 永久保証

Corsair Memory 社の DRAM メモリーモジュール製品には、すべて永久保証が適用されます。Corsair Memory 製品は、製品寿命の続く限り、または保証の及ぶ限り、意図されている運用環境でそれぞれのデータシートで指定されているとおりに動作することが保証されます。

【CMG6GX3M3A1600C7 製品詳細】

型番	CMG6GX3M3A1600C7
容量	6GB(2GB × 3枚セット)
規格	PC3-12800(DDR3-1600MHz)
種類	240Pin DDR3-SDRAM Unbuffered DIMM
転送クロック	1600MHz

サイズ	基板サイズ:39×133 mm 全体サイズ:53×133mm
レイテンシ	7-7-7-20
XMP	XMP 7-7-7-20 values at 1600MHz
トリプルチャンネル	対応
RoHS	適合
その他	Airflow ファン 同梱
ヒートシンク	DHX 搭載
保証	永久保証

【CMG6GX3M3A1600C7 発売詳細】

-発売日

2010年2月6日

-型番

CMG6GX3M3A1600C7

-店頭予想売価

34,700円前後

-高解像度ダウンロード

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=545>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/corsair-xms/cmg6gx3m3a1600c7.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>